



## Dünndraht Wedge-Wedge Bonder 5630

### Bond System

<b>Drahttypen</b>	Alu- und Golddrähte 17,5-75µm auf 2"-Spule
<b>Bondkopf</b>	Wedge-Wedge für Alu- und Golddrähte Standardkapillare 16mm Länge (optional 19mm) Motorisierte Drahtabspulung (optional)
<b>Ultraschall System</b>	F&S Generator 100kHz (optional 65, 140kHz)

### Maschinen Basis

#### Achsen

- Arbeitsbereich X/Y-Achse 100x100mm  
Z-Achse 60mm
- Schrittauflösung 0,25µm
- Wiederholgenauigkeit <2µm

#### Hardware

- Dual Core PC, 1,6 GHz Prozessor,
- 4 GB RAM, Ethernet, 4x USB-Hub Front
- Firewire CCD Farbkamera 1,4 MPixel
- Netzwerkfähig mit TCP/IP Server zur

#### Software

- Einzelbonds bis komplexe Programme,
- Loopformen in Bibliotheken speicherbar
- Optionale Bilderkennung

**Geschwindigkeit** 20 Drähte ≤ Minute

**Abmessung** B x T x H – 70 x 65 x 70 cm, Gewicht ca. 80kg

**Anschlüsse** 100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 500 VA  
Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch

**Heizung** Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

### Die 56xx Serie:

Der semiautomatische Gold-Ball-Bonder 5630 ist auf Basis der 56xx-Serie voll PC-gesteuert und es sind beliebig viele Bonds oder Bumps programmierbar.

Die programmierten Zielpunkte werden über das Kamerazielfadenkreuz angefahren und die programmierten Bonds oder Bumps werden automatisch gebondet.

F&S Bondtec bietet bei dieser Maschine zwei Modis an: Singlebond zum Reparieren von div. Bondsamples und zum Setzen von Einzelbonds (manuell -automatisch) und Multiwire zum Teachen und Bonden von Chips oder div. Bondsamples (semi- u. vollautomatisch).

Durch einfachen Wechsel der Bondköpfe und der Software kann diese Maschine auch auf Ball-Wedge, Dickdraht Wedge Wedge oder Heavy Ribbon Bonder umgerüstet werden. Ebenso ist die Maschine als Pull-/Sheartester einsetzbar.

Werkzeugloses Umrüsten ist in ca. 3 Minuten möglich.

## Substrathalter

Standard-Substrataufnahme  
für Bauteile bis 4x4" mit  
Vakuum und mechanischer Klemmung



## Optional:



Substrathalter 4x4"  
mit Stufenbacken



TO Aufnahme mit  
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.  
gummierter Oberfläche, mit  
mechanische Klemmung

### F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: [info@fsbondtec.at](mailto:info@fsbondtec.at)

Web: [www.fsbondtec.at](http://www.fsbondtec.at)

**Hilpert**  
electronics

Ihr Vertriebspartner/ Votre représentant:

Hilpert electronics AG  
Täferstrasse 29  
5405 Baden-Dättwil  
Schweiz / Suisse

Tel: +41 56 483 25 25  
Fax: +41 56 483 25 20  
Mail: [office@hilpert.ch](mailto:office@hilpert.ch)  
Web: [www.hilpert.ch](http://www.hilpert.ch)

